

证券代码：688261

证券简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023 年半年度业绩说明会)

编号：IR2023-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的全体投资者
会议地点	价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动
上市公司接待人员姓名	龚轶（董事长兼总经理）、李麟（董事兼董事会秘书）、谢长勇（财务负责人）、毕嘉露（独立董事）
交流时间	2023 年 09 月 12 日 10:00-11:00
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司的回购计划大概什么时候在董事会讨论？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司正在积极推进股份回购事项的落实工作，会严格按照相关规定及时履行信息披露义务，后续进展请关注公司披露的相关临时公告。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题二：公司汽车及工业级应用收入达到主营业务收入 81%，请问主要来自哪些领域？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2023 年上半年，公司汽车</p>

及工业级应用收入占主营业务收入的比例逾 81%，主要来自光伏逆变及储能、新能源汽车车载充电机、新能源汽车直流充电桩、5G 基站电源及通信电源、数据中心服务器电源和工业照明电源等领域。感谢您对公司的关注！

问题三：主持人您好，贵公司毛利率同比下滑 17.43%，主要是成本上涨导致，还是降价导致？

答：尊敬的投资者您好！进入 2023 年，因功率半导体海外龙头厂商加大中国市场竞争力度、国内产能的进一步释放以及下游需求的调整引致供求关系变化。经历了两年高歌猛进的半导体行业进入下行周期，产品价格呈现明显下降趋势，给国内众多公司相关产品持续的市场化推广带来较大压力，公司对产品价格进行了下调，影响了二季度营收，毛利率的下降主要系产品价格下调所致。感谢您对公司的关注！

问题四：将晶圆制造和封测环节委外代工的原因是什么？未来有考虑收并购相关企业吗？

答：尊敬的投资者您好！公司采用 Fabless 运营模式，将晶圆制造、封装、测试等生产制造环节进行外包，专注于芯片的研发与销售。公司未来如有收并购相关企业的计划，会严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问题五：公司的研发人员数为 60 人，虽然占总员工数 50%，但是在建项目和产品种类比较多，未来是否有考虑大幅增加高水平研发人员的计划？

答：尊敬的投资者您好！公司持续加强研发投入，包括但不限于积极扩充技术人才队伍、丰富产品品类与产品规格、持续进行前沿技术的研究开发、加强先进工艺产品研发投入等方面。2023年上半年，公司的研发费用投入为3,943.66万元，同比增长90.28%，相应的材料、职工薪酬、研发设备及平台开发等投入均持续增长。感谢您对公司的关注！

问题六：董秘您好，公司硅方碳、超级硅等产品是否进行加速放量，国内外客户铺开进展情况如何？

答：尊敬的投资者您好！2023年上半年公司SiC器件产品（含Si₂C MOSFET）持续出货，已经通过客户的验证，可以实现对传统SiC MOSFET的互相替代，实现营业收入6.07万元。超级硅MOSFET产品实现营业收入735.43万元，较2022年同期增长984.09%，主要应用于高密度电源，批量进入中车株洲、航嘉驰源、Enphase Energy等客户，开始进入禾迈股份、首航新能源、拓邦股份、金升阳等客户。为应对未来更加复杂的市场变化，公司将积极开拓国内外市场。感谢您对公司的关注！

问题七：公司“超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目”、“新结构功率器件研发及产业化项目”目前投产是否正常进行？3年后完成投产预计能带来什么收益？

答：尊敬的投资者您好！截至2023年半年度末，“超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目”和“新结构功率器件研发及产业化项目”两项募投项目进展符合计划进度。具体内容可详见公司

于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《苏州东微半导体股份有限公司 2023 年半年度报告》“第六节、第十二”之“募投项目明细”。

“超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目”实施旨在加强技术积淀,保持公司在高压超级结 MOSFET、中低压屏蔽栅 MOSFET 领域的优势,挖掘高可靠低成本产品的潜力,打造全系列功率半导体产品的技术创新平台。

“新结构功率器件研发及产业化项目”依托于公司现有核心技术,主要涉及 Tri-gate 结构 IGBT 器件设计及其工艺技术、Super-Silicon 超级硅 MOSFET 设计及其工艺技术及 Hybrid-FET 器件及其制造技术。实施完成后将助力公司纵向深耕超级结功率器件领域、横向拓展丰富产品线,占据并巩固功率器件市场份额。感谢您对公司的关注!

问题八:今年光伏装机量预计增长迅速,新能源汽车和充电桩需求猛增,公司在上游原料端是否会出现紧缺情况?

答:尊敬的投资者您好!进入 2023 年,功率半导体行业国内产能进一步释放,公司与行业上游的晶圆制造厂商、封装测试厂商等供应商建立了长期稳定的业务合作关系与高效的联动机制,可以持续获得充分的产能支持。感谢您对公司的关注!

问题九:公司上半年研发费用同比增长 90.28%的主要原因是什么?主要用于哪些项目、产品的研发?

答:尊敬的投资者您好!2023 年上半年,公司研发

费用同比增长 90.28%，主要系公司持续加强研发投入，特别是先进工艺产品研发，相应的材料、职工薪酬、研发设备及平台开发等投入的均持续增长所致。主要用于“超级硅功率器件”、“12 英寸先进工艺 GreenMOS 超级结 MOSFET”、“第三代半导体 SiC 功率器件研发”、“新能源汽车主驱专用高密度 TGBT 芯片研发”等十三项研发项目及产品。具体内容可详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司 2023 年半年度报告》“第三节、第二”之“核心技术与研发进展”。感谢您对公司的关注！

问题十：请问公司如果代工厂降代工费，我们产品定价会如何反应？时间是否滞后？

答：尊敬的投资者您好！因功率半导体海外龙头厂商加大中国市场竞争力度、国内产能的进一步释放以及下游需求的调整引致供求关系变化，2023 年第二季度公司对产品价格进行了下调，向上游代工厂的传导需要一定的时间。公司的定价策略是尽量维持合理的价格与毛利，维护与客户的长期合作关系，长期目标是维持稳定值，而不是追求短期内的巨大波动。感谢您对公司的关注！

问题十一：请问董事长，在车载功率器件领域的产品主要是什么？

答：尊敬的投资者您好！车载功率器件领域 DC/DC 模块、电驱系统、车载充电机均可以使用公司产品，主要以公司超级结 MOSFET、中低压 SGT MOSFET 和

	TGBT 产品为主。感谢您对公司的关注!
附件清单	无
日期	2023 年 9 月 12 日